

2025年11月27日

各 位

SBS 東芝ロジスティクス株式会社

## 「3D EXPERIENCE WORLD JAPAN 2025」でDX事例を発表 — 段ボール包装の落下衝撃解析で“物流を、超えていけ” —

SBS 東芝ロジスティクス株式会社（社長：金澤 寧、本社：東京都新宿区）は11月14日、ダッソー・システムズ株式会社が主催する「3D EXPERIENCE WORLD JAPAN 2025」（於：虎ノ門ヒルズフォーラム（東京都港区））において、当社の包装設計における構造解析活用のDX事例を発表したことをお知らせします。



「3D EXPERIENCE WORLD JAPAN 2025」はSOLIDWORKSブランドによる国内最大級の3次元CADイベントで、「One Step Beyond ～踏み出そう、つながる未来へ～」をテーマに、設計・製造・改善がつながり、価値を繰り返し生み出すものづくりや、アイデアが波紋のように広がり、一つの行動が次の創造を生み、変化を連鎖させていく、“SOLIDWORKSでつながる未来、設計のチカラ”を体感できる場として開催されました。

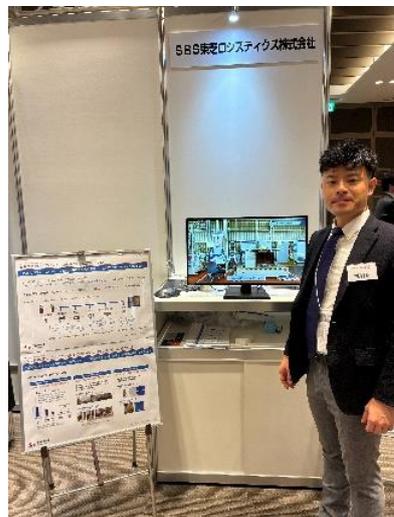
同イベントのユーザー事例講演に、当社の包装・治具技術担当の戸田太地（とだ たいち）が登場し、『段ボール包装の落下衝撃解析 ～物流を、超えていく～』と題したDX事例を発表して100名超に聴講いただきました。

本講演では、昨今の環境対応・脱プラスチックでエコな包装材として注目されている段ボールについて、当社の包装設計における構造解析の活用事例を発表しました。市販CAEでは段ボールの材料特性データ（素材強度値）が十分に揃っていない中、自社所有の試験設備で段ボールの材料試験を行うことにより、CAE利用できる材料特性データを作成し、製品を保護する包装材として段ボール落下衝撃解析へ挑戦することで、お客様への付加価値ソリューションにつなげました。



ユーザー事例講演の様子（写真：戸田 太地（包装・治具技術担当））

また、同日に講演企業としてブース出展し、当社の強みである包装技術ソリューションとして、DFL（デザイン・フォー・ロジスティクス）包装設計、ISO17025 認定包装試験、包装貨物衝撃シミュレーションの各種サービスを紹介して多くの方にお越しいただきました。



ブース出展の様子（写真：左から内田 幸義（包装・治具技術担当 グループ長）、戸田 太地（包装・治具技術担当））

当社は、今後もお客様へ最適なサービスを提供すべく、デジタル技術を最大限に活用しながら、包装・治具設計を通じてお客様の品質向上、環境負荷低減、コスト低減、作業性向上を図って参ります。

以 上

## ■ご参考

<ダッソー・システムズ株式会社 SOLIDWORKS 顧客事例>

URL : [https://www.solidworks.com/ja/story/sbs\\_toshiba\\_logistics](https://www.solidworks.com/ja/story/sbs_toshiba_logistics)

<SBS 東芝ロジスティクス株式会社 概要>

本社住所：東京都新宿区西新宿 8-17-1 住友不動産新宿グランドタワー25 階

代表者：代表取締役社長 金澤 寧

設立：1974 年 10 月 1 日

親会社：SBSホールディングス株式会社（持株比率 66.6%）

資本金：21 億 28 百万円

売上高：1,153 億円（2024 年 12 月期、連結）

従業員数：2,780 名（2024 年 12 月末現在、連結）

関連会社：国内にSBSロジスター(株)、海外は中国、アジア、米国、欧州各地域に 14 社

事業内容：倉庫業、貨物利用運送事業、機械器具設置工事業、とび・土工工事業、通関業  
航空運送代理店業、物流コンサルティング、不動産賃貸及び管理業 他

URL : <https://www.sbs-toshibalogistics.co.jp/>

## ■本件に関するお問い合わせ先

SBS 東芝ロジスティクス株式会社 人事総務部

TEL：03-6772-8201（代表）／URL：<https://www.webcoms.jp/sbstlog/contact/>

※ 当資料に掲載されている情報は、発表日現在の情報です。その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご了承ください。